



H2105 环氧底部填充胶

产品描述

H2105 是一款单组分加热固化的环氧胶粘剂。主要用于 CSP 或 BGA 底部填充，对芯片进行补强，提高产品的可靠性。H2105 为低卤环保产品，室温下流动性好，中温下固化，具有优异的耐化学溶剂和电性能。高 Tg，高温下性能稳定性佳。

产品特性

项目	规格
化学类型	改性环氧树脂
外观	黑色液体
组分	单组分
固化方式	加热
典型应用	BGA、CSP等底部填充，FPC加固补强

产品优点

- 低 CTE;高 Tg 值，耐温性好
- 低卤环保，可返修
- 室温快速流动
- 中温快速固化，与大多数助焊剂残留物兼容性好
- 优异的可靠性

未固化时性能

项目	典型值	备注
粘度 cps	400	GB/T 2794 20rpm
比重 g/ml	1.16	GB/T 13354
开放时间	3 天	@ 25° C, 25% 粘度上升



固化后性能

在推荐条件下固化：

项目			典型值	备注
物理性能	固化收缩率	CTE1 ppm/° C	50	TMA
		CTE2 ppm/° C	165	
	玻璃化转变温度 (Tg) °C		115	TMA
	杨氏模量		2,650 N/mm²	GB/T 22315
			382,000 psi	
电性能	介电常数	3.10		ASTM D150 @1GHz
		3.15		ASTM D150 @2GHz
	耗散系数	0.0097		ASTM D149 @1GHz
		0.0089		ASTM D149 @2GHz

固化条件

推荐固化条件

加热固化	8 min @130° C
	30 min @110° C

以上固化条件为指导性建议，固化条件(时间和温度)可能依据客户经验、应用要求、固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而不同。

使用方法

- 1、使用前从冰箱中取出回温:推荐回温时间: 10mm 针筒装 1h, 30-50mm 为 2-4h。推荐回温条件:温度 28° C 以下, 湿度 65%RH 以下。
- 2、回温温度未达到室温时请勿打开包装。打开包装前请确认外包装上没有水分。
- 3、推荐使用条件:请在温度 28° C 以下, 湿度 65%RH 以下使用。
- 4、开封后请在 72 小时内用完。使用中避免污染, 用过的产品不能放回原包装中。
- 5、未固化的胶粘剂可用与环氧树脂相溶的溶剂清洗。
- 6、有关此产品的安全事项, 请参考 MSDS。



包装规格

- 30ml, 50ml, 250ml /罐
- 根据客户要求

产品储存

本产品最佳存储条件：-18° C 以下，存储期 6 个月。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在所述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注:本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com